

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该内容而引致的任何损失承担任何责任。



## HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

### 华虹半导体有限公司

(于香港注册成立之有限公司)

(股份代号: 01347)

## 新闻稿

### 二零二六年第一季度业绩公布

*所有货币以美元列帐，除非特别指明。*

*本合并财务报告系依香港财务报告准则编制。*

中国香港 — 2026年5月14日 — 全球领先的特色工艺纯晶圆代工厂华虹半导体有限公司（香港联交所股票代码：01347；上交所科创板证券代码：688347）（“本公司”）于今日公布截至二零二六年三月三十一日止三个月的综合经营业绩。

#### 二零二六年第一季度主要财务指标（未经审核）

- 销售收入达 6.609 亿美元，同比增长 22.2%，环比增长 0.2%。
- 毛利率 13.0%，同比上升 3.8 个百分点，环比持平。
- 母公司拥有人应占利润 2,090 万美元，同比上升 458.1%，环比上升 19.9%。

#### 二零二六年第二季度指引

- 我们预计销售收入约在 6.9 亿美元至 7.0 亿美元之间。
- 我们预计毛利率约在 14%至 16%之间。

## 总裁致辞

华虹半导体董事会主席兼总裁白鹏博士对公司二零二六年第一季度业绩评论道：

“华虹半导体二零二六年第一季度实现销售收入 6.609 亿美元，同比增长 22.2%；毛利率为 13.0%，同比上升 3.8 个百分点。两项指标均符合指引预期。本季度母公司拥有人应占利润达 2,090 万美元，同比大幅增长。在产能快速爬坡的同时，公司依旧保持高产能利用率，各工艺技术平台均表现强劲；其中 MCU、独立式闪存以及 BCD 工艺产品增长最为显著。得益于公司在降本增效方面的持续努力，以及自季度初开始显现并在整个季度不断增强的积极需求信号，公司业绩表现稳健。”

白总继续表示：“随着人工智能及相关应用在行业发展和市场格局中的作用日益增强，全球半导体产业正加速演变。人工智能对全球半导体市场需求的显著拉动，与全球供应链格局持续存在的不确定性交织，共同构成了我们当前所面对的更加复杂的市场环境。华虹半导体始终坚守特色工艺晶圆代工龙头企业的战略目标，持续聚焦市场需求、不断强化工艺能力并提升产能规模。第一季度，公司 12 英寸产能爬坡稳步推进、收入占比已提升至 62.7%；8 英寸产线继续保持良好盈利能力。与此同时，拟议收购华力微事项已获上交所受理并进入实质审核阶段，正在按照既定计划推进，预期可于今年下半年完成。最后，作为一名深耕行业多年的半导体从业者，我始终对全球及中国半导体产业的未来充满信心。我将全力推动华虹半导体不断提升行业地位和影响力，并为股东创造持久价值。”

## 电话会议公告

日期 2026 年 5 月 14 日，星期四

时间： 17:00 香港/上海时间

05:00 美国东部时间

发言人： 白鹏，董事会主席兼总裁

王鼎，执行副总裁兼首席财务官

广播： 会议将在 [https://www.huahonggrace.com/c/ir\\_calendar.php](https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php) 或

<https://edge.media-server.com/mmc/p/hzh37nq7> 作线上直播

（请提前注册登记）

电话直拨： 请在会议前使用以下链接先进行注册。注册后，您将收到确认邮件获得拨入号码及 PIN（个人身份识别码）。

<https://register-conf.media-server.com/register/Blcb1a74a561af4a9393c1c207872566c1>

**重要提示：** 在会议开始前，您需要使用确认邮件中提供的 PIN（个人身份识别码）才能进入会议。请在注册后，注意查收并保存确认邮件。出于安全原因，请不要与任何人共享您的 PIN（个人身份识别码）。

网上回放： 直播约 2 小时后，您可在 12 个月内在以下网页重复收听会议。

[https://www.huahonggrace.com/c/ir\\_calendar.php](https://www.huahonggrace.com/c/ir_calendar.php)

## 关于华虹半导体

华虹半导体有限公司（A 股简称：华虹公司，688347；港股简称：华虹半导体，01347）（“本公司”）是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业，秉持“8 英寸 + 12 英寸”、先进“特色 IC + Power Discrete”的发展战略，为客户提供多元化的晶圆代工及配套服务。本公司专注于嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理和逻辑与射频等特色工艺技术的持续创新，有力支持新能源汽车、绿色能源、物联网等新兴领域应用，其卓越的质量管理体系亦满足汽车电子芯片生产的严苛要求。本公司是华虹集团的一员，而华虹集团是中国拥有“8 英寸 + 12 英寸”先进集成电路制造主流工艺技术的产业集团。

本公司在上海金桥和张江建有三座 8 英寸晶圆厂，另在无锡高新技术产业开发区内建有两座全球领先的 12 英寸特色工艺晶圆厂，其中之一是全球第一条 12 英寸功率器件代工生产线。

如欲取得更多公司相关资料，请浏览：[www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

**经营业绩概要**  
(以千美元计, 每股盈利和营运数据除外)

	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售收入	660,925	540,937	659,882	22.2 %	0.2 %
<b>毛利</b>	<b>86,059</b>	<b>49,997</b>	<b>85,464</b>	<b>72.1 %</b>	<b>0.7 %</b>
<b>毛利率</b>	<b>13.0 %</b>	<b>9.2 %</b>	<b>13.0 %</b>	<b>3.8</b>	<b>-</b>
经营开支	(105,613)	(97,110)	(130,165)	8.8 %	(18.9)%
其他(损失)/收入净额	(2,448)	(8,294)	34,110	(70.5)%	(107.2)%
<b>税前损失</b>	<b>(22,002)</b>	<b>(55,407)</b>	<b>(10,591)</b>	<b>(60.3)%</b>	<b>107.7 %</b>
所得税抵免/(开支)	4,735	3,245	(8,069)	45.9 %	(158.7)%
<b>期内损失</b>	<b>(17,267)</b>	<b>(52,162)</b>	<b>(18,660)</b>	<b>(66.9)%</b>	<b>(7.5)%</b>
<b>净利润率</b>	<b>(2.6)%</b>	<b>(9.6)%</b>	<b>(2.8)%</b>	<b>7.0</b>	<b>0.2</b>
以下各方应占:					
母公司拥有人	20,929	3,750	17,454	458.1 %	19.9 %
非控股权益	(38,196)	(55,912)	(36,114)	(31.7)%	5.8 %
持有人应占每股盈利					
基本	0.012	0.002	0.010	500.0 %	20.0 %
摊薄	0.012	0.002	0.010	500.0 %	20.0 %
付运晶圆(折合 8 吋千片)	1,453	1,231	1,448	18.0 %	0.3 %
产能利用率 <sup>1</sup>	99.7%	102.7 %	103.8 %	(3.0)	(4.1)
净资产收益率 <sup>2</sup>	1.2 %	0.4 %	1.2 %	0.8	-

**二零二六年第一季度**

- 销售收入达 6.609 亿美元, 同比增长 22.2%, 主要得益于付运晶圆数量上升及平均销售价格上涨; 环比增长 0.2%。
- 毛利率 13.0%, 同比上升 3.8 个百分点, 主要得益于平均销售价格提升及降本增效; 环比持平。
- 经营开支 1.056 亿美元, 同比上升 8.8%, 主要由于无锡新生产线的营运费用上升; 环比下降 18.9%, 主要由于人工开支下降。
- 其他损失净额 240 万美元, 同比减少损失 70.5%, 主要由于本期取得外币汇兑收益而上年同期为外币汇兑损失, 部分被政府补贴及利息收入减少和财务费用上升所抵消; 上季度为其他收入净额 3,410 万美元, 主要由于财务费用上升及政府补贴下降。
- 所得税抵免 470 万美元, 由于本期转回 2025 年度计提的代扣代缴股息税。
- 期内损失 1,730 万美元, 同比减亏 66.9%, 环比减亏 7.5%。
- 母公司拥有人应占利润 2,090 万美元, 同比上升 458.1%, 环比上升 19.9%。
- 基本每股盈利 0.012 美元。
- 净资产收益率(年化) 1.2%。

<sup>1</sup>产能利用率按平均月约当产量除以总估计月产能计算。

<sup>2</sup>母公司拥有人应占利润/加权平均母公司拥有人应占净资产。

销售收入分析

按类别划分的 销售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第一季度 % (未经审核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
晶圆	635,843	96.2 %	515,574	95.3 %	120,269	23.3 %
其他	25,082	3.8 %	25,363	4.7 %	(281)	(1.1)%
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度 96.2%的销售收入来源于半导体晶圆的直接销售。

销售收入分析

按晶圆尺寸划分的 销售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第一季度 % (未经审核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
8 吋晶圆	246,380	37.3 %	231,086	42.7 %	15,294	6.6 %
12 吋晶圆	414,545	62.7 %	309,851	57.3 %	104,694	33.8 %
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度来自于 8 吋晶圆和 12 吋晶圆的销售收入分别为 2.464 亿美元及 4.145 亿美元。

### 销售收入分析

按地域划分的 销售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第一季度 % (未经审核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
中国 <sup>3</sup>	525,209	79.5 %	442,458	81.8 %	82,751	18.7 %
北美 <sup>4</sup>	85,701	13.0 %	56,427	10.4 %	29,274	51.9 %
亚洲其他 <sup>5</sup>	28,211	4.2 %	26,824	5.0 %	1,387	5.2 %
欧洲	21,804	3.3 %	15,228	2.8 %	6,576	43.2 %
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度来自于中国的销售收入 5.252 亿美元，占销售收入总额的 79.5%，同比增长 18.7%，主要得益于 MCU、其他电源管理、闪存及 IGBT 产品的需求增加。
- 本季度来自于北美的销售收入 8,570 万美元，同比增长 51.9%，主要得益于其他电源管理及 MCU 产品的需求增加。
- 本季度来自于亚洲其他地区的销售收入 2,820 万美元，同比增长 5.2%，主要得益于 MCU 产品的需求增加，部分被超级结产品的需求下降所抵消。
- 本季度来自于欧洲的销售收入 2,180 万美元，同比增长 43.2%，主要得益于智能卡芯片、IGBT 及 MCU 产品的需求增加。

<sup>3</sup> 包括中国大陆及中国香港。

<sup>4</sup> 包括于 2020 年由一家总部位于欧洲的公司所收购的一家主要美国客户。

<sup>5</sup> 包括中国台湾及日本。

### 销售收入分析

按技术平台划分的 销售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第一季度 % (未经审核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
嵌入式非易失性存储	184,610	27.9 %	130,290	24.1 %	54,320	41.7 %
独立式非易失性存储	57,098	8.6 %	42,875	7.9 %	14,223	33.2 %
功率器件	170,919	25.9 %	162,751	30.1 %	8,168	5.0 %
逻辑及射频	74,381	11.3 %	66,787	12.3 %	7,594	11.4 %
模拟与电源管理	173,917	26.3 %	138,234	25.6 %	35,683	25.8 %
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度嵌入式非易失性存储器销售收入 1.846 亿美元，同比增长 41.7%，主要得益于 MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度独立式非易失性存储器销售收入 5,710 万美元，同比增长 33.2%，主要得益于闪存产品的需求增加。
- 本季度功率器件销售收入 1.709 亿美元，同比增长 5.0%，主要得益于 IGBT 及通用 MOSFET 产品需求增加，部分被超级结产品的需求下降所抵消。
- 本季度逻辑及射频销售收入 7,440 万美元，同比增长 11.4%，主要得益于逻辑及 CIS 产品的需求增加。
- 本季度模拟与电源管理销售收入 1.739 亿美元，同比增长 25.8%，主要得益于其他电源管理产品的需求增加。

### 销售收入分析

按工艺技术节点划分的销售收入	二零二六年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二六年 第一季度 % (未经审核)	二零二五年 第一季度 千美元 (未经审核)	二零二五年 第一季度 % (未经审核)	同比 千美元	同比 %
65nm 及以下	179,374	27.1 %	124,280	23.0 %	55,094	44.3 %
90nm 及 95nm	167,479	25.3 %	128,864	23.8 %	38,615	30.0 %
0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m	70,751	10.7 %	54,059	10.0 %	16,692	30.9 %
0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m	34,071	5.2 %	29,938	5.5 %	4,133	13.8 %
0.25 $\mu$ m	1,397	0.2 %	3,517	0.7 %	(2,120)	(60.3)%
0.35 $\mu$ m 及以上	207,853	31.5 %	200,279	37.0 %	7,574	3.8 %
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度 65nm 及以下工艺技术节点的销售收入 1.794 亿美元，同比增长 44.3%，主要得益于其他电源管理及闪存产品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工艺技术节点的销售收入 1.675 亿美元，同比增长 30.0%，主要得益于 MCU、其他电源管理及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 $\mu$ m 及 0.13 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 7,080 万美元，同比增长 30.9%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。
- 本季度 0.15 $\mu$ m 及 0.18 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 3,410 万美元，同比增长 13.8%，主要得益于 MCU 及其他电源管理产品的需求增加。
- 本季度 0.25 $\mu$ m 工艺技术节点的销售收入 140 万美元，同比下降 60.3%，主要由于功率器件及逻辑产品的需求下降。
- 本季度 0.35 $\mu$ m 及以上工艺技术节点的销售收入 2.079 亿美元，同比增长 3.8%，主要得益于 IGBT 及通用 MOSFET 产品的需求增加，部分被超级结产品的需求下降所抵消。

### 销售收入分析

按终端市场分布划分的销售收入	二零二六年	二零二六年	二零二五年	二零二五年	同比	同比
	第一季度 千美元 (未经审核)	第一季度 %	第一季度 千美元 (未经审核)	第一季度 %	千美元	%
消费电子	444,356	67.2 %	348,100	64.3 %	96,256	27.7 %
工业及汽车	143,150	21.7 %	119,878	22.2 %	23,272	19.4 %
通信	62,667	9.5 %	65,264	12.1 %	(2,597)	(4.0)%
计算	10,752	1.6 %	7,695	1.4 %	3,057	39.7 %
<b>销售收入总额</b>	<b>660,925</b>	<b>100.0 %</b>	<b>540,937</b>	<b>100.0 %</b>	<b>119,988</b>	<b>22.2 %</b>

- 本季度消费电子作为我们的第一大终端市场，贡献销售收入 4.444 亿美元，占销售收入总额的 67.2%，同比增长 27.7%，主要得益于其他电源管理、MCU 及闪存产品的需求增加。
- 本季度工业及汽车产品销售收入 1.432 亿美元，同比增长 19.4%，主要得益于 MCU、智能卡芯片及 IGBT 产品的需求增加。
- 本季度通信类产品销售收入 6,270 万美元，同比下降 4.0%，主要由于模拟产品需求下降。
- 本季度计算类产品销售收入 1,080 万美元，同比增长 39.7%，主要得益于 MCU 产品的需求增加。

### 产能<sup>6</sup>及产能利用率

	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)
总产能(折合 8 吋千片晶圆)	489	413	486
总体产能利用率	99.7%	102.7%	103.8%

- 本季度末月产能 489,000 片 8 吋等值晶圆。总体产能利用率为 99.7%。

### 付运晶圆

折合 8 吋千片晶圆	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
付运晶圆	1,453	1,231	1,448	18.0 %	0.3 %

- 本季度付运晶圆 1,453,000 片，同比上升 18.0%，环比上升 0.3%。

<sup>6</sup> 期末月产能，且为比较目的，以 30 天作为计算基础。

### 经营开支分析

以千美元计	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
销售及分销费用	2,358	2,214	3,791	6.5 %	(37.8)%
管理费用 <sup>7</sup>	103,255	94,896	126,374	8.8 %	(18.3)%
<b>经营开支</b>	<b>105,613</b>	<b>97,110</b>	<b>130,165</b>	<b>8.8 %</b>	<b>(18.9)%</b>

- 经营开支 1.056 亿美元，同比上升 8.8%，主要由于无锡新生产线的营运费用上升；环比下降 18.9%，主要由于人工开支下降。

### 其他(损失)/收入净额

以千美元计	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
租金收入	3,229	3,513	3,932	(8.1)%	(17.9)%
利息收入	10,394	15,619	15,228	(33.5)%	(31.7)%
汇兑收入/(损失)	5,105	(16,199)	7,014	(131.5)%	(27.2)%
分占联营公司溢利	153	652	1,261	(76.5)%	(87.9)%
财务费用	(27,681)	(23,301)	(8,414)	18.8 %	229.0 %
政府补贴	5,634	11,231	16,280	(49.8)%	(65.4)%
其他	718	191	(1,191)	275.9 %	(160.3)%
<b>其他(损失)/收入净额</b>	<b>(2,448)</b>	<b>(8,294)</b>	<b>34,110</b>	<b>(70.5)%</b>	<b>(107.2)%</b>

- 其他损失净额 240 万美元，同比减少损失 70.5%，主要由于本期取得外币汇兑收益而上年同期为外币汇兑损失，部分被政府补贴及利息收入减少和财务费用上升所抵消。上季度为其他收入净额 3,410 万美元，主要由于财务费用上升及政府补贴下降。

<sup>7</sup>管理费用包括确认为研发开支抵减项目的政府补助。

### 现金使用分析

以千美元计	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)	同比	环比
经营活动所得现金流量净额	130,427	50,186	246,026	159.9 %	(47.0)%
投资活动所用现金流量净额	(856,988)	(494,291)	(652,811)	73.4 %	31.3 %
融资活动所得现金流量净额	638,664	59,137	1,361,101	980.0 %	(53.1)%
外汇汇率变动影响净额	61,962	5,771	34,759	973.7 %	78.3 %
<b>现金及现金等价物变动影响净额</b>	<b>(25,935)</b>	<b>(379,197)</b>	<b>989,075</b>	<b>(93.2)%</b>	<b>(102.6)%</b>

- 本季度经营活动所得现金流量净额1.304亿美元，同比上升159.9%，主要由于客户收款上升；环比下降47.0%，主要由于收到的政府补助下降及支付的人工开支上升。
- 投资活动所用现金流量净额8.570亿美元，其中包括固定资产投资支出9.249亿美元，部分被收到定期存款5,780万美元，利息收入1,000万美元及设备处置款10万美元所抵消。
- 融资活动所得现金流量净额6.387亿美元，其中提取银行借款6.494亿美元及员工行权发行股份收到330万美元，部分被支付利息1,210万美元、支付租赁负债110万美元及偿还银行借款80万美元所抵消。

### 资本结构

以千美元计	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二五年 (已审核)
资产总额	14,947,323	14,453,772
负债总额	5,662,963	5,289,541
所有者权益总额	9,284,360	9,164,231
资产负债率 <sup>8</sup>	37.9%	36.6%

### 资本开支

以千美元计	二零二六年 第一季度 (未经审核)	二零二五年 第四季度 (未经审核)
华虹 8 吋	38,725	74,527
华虹 12 吋	886,146	558,847
<b>合计</b>	<b>924,871</b>	<b>633,374</b>

- 本季度资本开支9.249亿美元，其中8.861亿美元用于华虹12吋，3,870万美元用于华虹8吋。

<sup>8</sup> 资产负债率=负债总额/资产总额。

## 流动性分析

以千美元计	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二五年 (已审核)
已竣工待售物业	218,918	215,511
存货	533,311	544,368
贸易应收款项及应收票据	313,053	282,053
预付款项、其他应收款项及其他资产	661,570	561,328
应收关联方款项	14,153	10,135
已冻结及定期存款	44,646	99,494
现金及现金等价物	4,867,873	4,893,808
<b>流动资产总额</b>	<b>6,653,524</b>	<b>6,606,697</b>
贸易应付款项	270,387	330,370
其他应付款项及暂估费用	735,491	1,008,586
计息银行借款	811,820	403,748
租赁负债	4,652	3,229
政府补助	90,371	89,049
应付关联方款项	4,996	6,225
应付所得税	17,912	15,014
<b>流动负债总额</b>	<b>1,935,629</b>	<b>1,856,221</b>
<b>净营运资金</b>	<b>4,717,895</b>	<b>4,750,476</b>
速动比率	3.0x	3.1x
流动比率	3.4x	3.6x
贸易应收款项及应收票据周转天数	41	37
存货周转天数	84	83

- 贸易应收款项及应收票据由上季度末的 2.821 亿美元上升至本季度末的 3.131 亿美元，主要由于销售收入增加。
- 预付款项、其他应收款项及其他资产由上季度末的 5.613 亿美元上升至本季度末的 6.616 亿美元，主要由于增值税留抵税额增加。
- 已冻结及定期存款由上季度末的 9,950 万美元下降至本季度末的 4,460 万美元，主要由于定期存款减少。
- 贸易应付款项由上季度末的 3.304 亿美元下降至本季度末的 2.704 亿美元，主要由于本期支付供应商款项增加。
- 其他应付款项及暂估费用由上季度末的 10.086 亿美元下降至本季度末的 7.355 亿美元，主要由于本季度支付的资本支出上升。
- 计息银行借款由上季度末的 4.037 亿美元上升至本季度末的 8.118 亿美元，主要由于长期银行借款的一年内到期部分增加。
- 净营运资金本季度末 47.179 亿美元，流动比率 3.4。
- 贸易应收款项及应收票据周转天数 41 天。
- 存货周转天数 84 天。

上述公布详情请参阅华虹半导体网站 [www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com)。

华虹半导体有限公司  
 简明损益表(以千美元计, 每股盈利和股数除外)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)
销售收入	660,925	540,937	659,882
销售成本	(574,866)	(490,940)	(574,418)
<b>毛利</b>	<b>86,059</b>	<b>49,997</b>	<b>85,464</b>
其他收入及收益	25,100	30,563	44,107
投资物业的公平值损失	-	-	(2,844)
销售及分销费用	(2,358)	(2,214)	(3,791)
管理费用	(103,255)	(94,896)	(126,374)
其他费用	(20)	(16,208)	-
财务费用	(27,681)	(23,301)	(8,414)
分占联营公司溢利	153	652	1,261
<b>税前损失</b>	<b>(22,002)</b>	<b>(55,407)</b>	<b>(10,591)</b>
所得税抵免/(开支)	4,735	3,245	(8,069)
<b>期内损失</b>	<b>(17,267)</b>	<b>(52,162)</b>	<b>(18,660)</b>
以下各方应占：			
母公司拥有人	20,929	3,750	17,454
非控股权益	(38,196)	(55,912)	(36,114)
持有人应占每股盈利			
基本	0.012	0.002	0.010
摊薄	0.012	0.002	0.010
<b>用于计算持有人应占每股基本盈利的     期内已发行普通股加权平均数</b>	<b>1,737,629,193</b>	<b>1,721,931,435</b>	<b>1,736,132,077</b>
<b>用于计算持有人应占每股摊薄盈利的     期内已发行普通股加权平均数</b>	<b>1,737,760,230</b>	<b>1,728,142,630</b>	<b>1,736,269,454</b>

华虹半导体有限公司  
简明综合财务状况表(以千美元计)

	截至		
	于三月三十一日	于十二月三十一日	于三月三十一日
	二零二六年 (未经审核)	二零二五年 (已审核)	二零二五年 (未经审核)
<b>资产</b>			
<b>非流动资产</b>			
物业、厂房及设备	7,105,886	6,676,442	5,967,555
投资物业	223,247	219,772	209,257
使用权资产	64,125	64,482	76,359
无形资产	32,834	35,509	29,122
于联营公司的投资	152,751	150,222	140,650
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具	486,369	478,799	289,722
长期预付款项	228,587	221,849	57,989
递延所得税资产	-	-	380
<b>非流动资产总额</b>	<b>8,293,799</b>	<b>7,847,075</b>	<b>6,771,034</b>
<b>流动资产</b>			
已竣工待售物业	218,918	215,511	221,061
存货	533,311	544,368	468,597
贸易应收款项及应收票据	313,053	282,053	286,763
预付款项、其他应收款项及其他资产	661,570	561,328	411,207
应收关联方款项	14,153	10,135	16,520
已冻结存款及定期存款	44,646	99,494	31,669
现金及现金等价物	4,867,873	4,893,808	4,079,935
<b>流动资产总额</b>	<b>6,653,524</b>	<b>6,606,697</b>	<b>5,515,752</b>
<b>流动负债</b>			
贸易应付款项	270,387	330,370	255,321
其他应付款项及暂估费用	735,491	1,008,586	759,177
计息银行借款	811,820	403,748	329,972
租赁负债	4,652	3,229	7,543
政府补助	90,371	89,049	57,700
应付关联方款项	4,996	6,225	12,724
应付所得税	17,912	15,014	18,620
<b>流动负债总额</b>	<b>1,935,629</b>	<b>1,856,221</b>	<b>1,441,057</b>
<b>流动资产净额</b>	<b>4,717,895</b>	<b>4,750,476</b>	<b>4,074,695</b>
<b>总资产减流动负债</b>	<b>13,011,694</b>	<b>12,597,551</b>	<b>10,845,729</b>
<b>非流动负债</b>			
计息银行借款	3,085,413	2,787,096	1,948,409
租赁负债	13,476	15,679	15,160
递延税项负债	24,463	35,964	1,498
其他非流动负债	603,982	594,581	-
<b>非流动负债总额</b>	<b>3,727,334</b>	<b>3,433,320</b>	<b>1,965,067</b>
<b>净资产</b>	<b>9,284,360</b>	<b>9,164,231</b>	<b>8,880,662</b>
<b>权益和负债权益</b>			
股本	4,987,537	4,987,482	4,957,182
储备	1,743,223	1,625,181	1,315,995
<b>本公司拥有人应占权益</b>	<b>6,730,760</b>	<b>6,612,663</b>	<b>6,273,177</b>
非控股权益	2,553,600	2,551,568	2,607,485

权益总额	9,284,360	9,164,231	8,880,662
------	-----------	-----------	-----------

华虹半导体有限公司  
简明综合现金流量表(以千美元计)

	截至以下日期止三个月		
	于三月三十一日 二零二六年 (未经审核)	于三月三十一日 二零二五年 (未经审核)	于十二月三十一日 二零二五年 (未经审核)
<b>经营活动现金流量:</b>			
税前亏损	(22,002)	(55,407)	(10,591)
折旧及摊销	214,606	172,126	195,876
应占联营公司溢利	(153)	(652)	(1,261)
营运资金的变动及其它	(62,024)	(65,881)	62,002
<b>经营活动所得现金流量净额</b>	<b>130,427</b>	<b>50,186</b>	<b>246,026</b>
<b>投资活动现金流量:</b>			
购买物业、厂房、设备及无形资产项目	(924,871)	(510,851)	(633,374)
投资其他权益工具	-	-	(3,557)
收到政府对设备的补助	-	-	36,596
定期存款的减少/(增加)	57,794		(67,152)
其他投资活动所得现金流量	10,089	16,560	14,676
<b>投资活动所用现金流量净额</b>	<b>(856,988)</b>	<b>(494,291)</b>	<b>(652,811)</b>
<b>融资活动现金流量:</b>			
提取银行贷款	649,364	860,985	919,025
发行股份所得收益	3,343	13,077	4,740
偿还银行贷款	(828)	(811,156)	(136,107)
已付利息	(12,137)	(3,252)	(32,834)
支付租赁负债	(1,078)	(517)	(428)
收到政府对财务费用的补助	-	-	12,124
其他融资活动收到的现金	-	-	594,581
<b>融资活动所得现金流量净额</b>	<b>638,664</b>	<b>59,137</b>	<b>1,361,101</b>
现金及现金等价物(减少)/增加净额	(87,897)	(384,968)	954,316
期初现金及现金等价物	4,893,808	4,459,132	3,904,733
外汇汇率变动影响净额	61,962	5,771	34,759
<b>期末现金及现金等价物</b>	<b>4,867,873</b>	<b>4,079,935</b>	<b>4,893,808</b>

于本公告日期，本公司董事分别为：

**执行董事**

白鹏(董事长兼总裁)

**非执行董事**

叶峻

孙国栋

陈博

熊承艳

**独立非执行董事**

张祖同

王桂堃太平绅士

封松林

承董事会命

**华虹半导体有限公司**

白鹏

董事长兼执行董事

中国 香港

二零二六年五月十四日